



非破壊・非接触熱構造解析技術【nonTAP法】Laser Bond Tester

○本社所在地：愛知県岡崎市 針崎1丁目1番地16

○事業概要：電線加工を起点とした電気機器製造、各種装置、検査装置の開発・製造・販売、変圧器等の販売

「Laser Bond Tester (LBT)」事業

○常時使用する従業員：220名

（グループ全体・2025年6月時点）

○現在の売上高：18.2億円

（グループ全体・2025年5月期）

○法人番号：2180301001289

○Web：<http://www.takeshiro.co.jp>

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役社長
酒井 快弥

竹代は、『八方良し』のバランスを取り、幸せの源泉を提供し続ける企業を目指す。

株式会社竹代は、創業70年の「ものづくり」の知見と、「**Laser Bond Tester (LBT)**」事業の革新的な「微小金属接合・非破壊熱構造解析技術【nonTAP法】」を融合させます。現在、地政学リスク等により世界の半導体サプライチェーンは「品質と信頼の危機」に直面しています。私たちは、破壊検査では見えない「電気伝導性」を可視化する本技術により、AI半導体やEVバッテリーなど「国家戦略技術」の品質を底支えします。私たちは、単なる装置メーカーを超え、「世界の品質基準（グローバルスタンダード）を創出する企業」へと変革し、日本の産業競争力強化と、全てのステークホルダーへの「安全と信頼」の提供を宣言します。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

「2028年に売上高100億円達成を目指す」

2028年：グループ売上高 120億円（グローバル量産体制の確立）
2033年：グループ売上高 300億円以上の達成（品質インフラとしての霸権確立） 「**Laser Bond Tester (LBT)**」を、世界の半導体・電子部品産業における「品質保証の必須インフラ（デファクトスタンダード）」として定着させる。

課題

1.供給責任の履行(生産能力):世界的な品質危機（チャイナリスク等）を受け急増する需要に対し、現在の生産体制では供給が追いつかず、サプライチェーンのボトルネックとなっている。

2.国際標準化への壁:日本発の独自技術を「国際規格(IEC)」へと昇華させるための、政治的・技術的リソースの不足。

3.市場のパラダイムシフト:従来の「破壊検査」から「非破壊全数検査」への転換を促すための、啓蒙と実績作り。

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

コンソーシアム総力戦:竹代リソース（ISO/UL準拠）と製造連携パートナーと共に2028年までに年間150台規模の量産体制を確立。機会損失をなくし、半導体供給網を強靭化する。

ルールメイキング戦略: JEITAおよびIECを通じ、「**nonTAP法**」の国際標準化（2026-27年目途）を推進。技術の公共性を高め、市場全体への普及を加速させる。

応用分野の拡大: AI半導体（インターポーラ）に加え、車載用バッテリー、医療機器分野へ横展開し、複数の事業の柱を構築する。

実施体制

LBT事業(頭脳):コア技術【nonTAP法】開発、知財戦略、国際規格化推進、グローバルマーケティング。

竹代事業(身体・幹事):コアユニット量産製造、サプライチェーン構築、資金管理、国内営業支援。

連携パートナー:国内外のトップティア企業（自動車・半導体）及び有力商社と連携し、販売・保守網を構築。

150兆円市場を支える「品質の守護神」

1. 「150兆円市場」の品質危機と高密度化されたICチップ制御のパラダイムシフト

2030年、世界の半導体市場は1兆ドル（約150兆円）規模に達すると予測されています。[出典: McKinsey & Company] その成長を牽引するのは、AI半導体（予測：44兆円規模）やパワー半導体（予測：11兆円規模）といった「高付加価値デバイス」です。これら先端品は、高度な微細化・積層化により「製造難易度」が極限まで高まり、ICチップからの高出力の適切な導通が鍵となっており、従来の抜き取り検査では品質を担保できません。市場は、「作れば売れる」時代から「品質を証明できた者だけが勝つ」時代へ突入していきます。

2. 「3兆円」の検査市場における「空白のブルーオーシャン」

この品質要求の高まりを受け、半導体検査・試験装置の市場規模は2030年に約3兆円（200億ドル）へ拡大すると予測されています。しかし、既存の検査技術は「外観（表面）」や「破壊（点）」に留まっており、最も重要な「内部接合の電気伝導性」を非破壊で全数検査できる技術は、世界に【nonTAP法】しか存在しません。本技術の導入は、歩留まり向上による廃棄ロス削減とデバイス自体の低抵抗化を通じ、半導体メーカーのみならず業界全体の「電力効率向上（GX）」に直結します。

3. 計画の蓋然性：シェアわずか「3%」からの霸権確立

私たちが目指す「2028年売上100億円」は、この3兆円市場のわずか「約3%」に過ぎません。さらに、長期目標である2033年の売上350億円でさえ、市場シェア「約12%」という現実的な数値です。「国家戦略技術（AI・EV）」における必須インフラ（デファクトスタンダード）として【nonTAP法】が採用されれば、ニッチトップを超えて業界標準（10%超）の座を獲得することは必然であり、この計画数値は極めて堅実な着地点となります。

